



**Toshiba presenta la piattaforma di sviluppo per i dispositivi Fit Fast Structured Array da 130nm**

*I clienti potranno beneficiare di alte prestazioni, bassi consumi e costi inferiori*

**Düsseldorf, Germania, 19 Novembre 2018** – Toshiba Electronics Europe ("Toshiba") ha annunciato oggi la prima consegna in assoluto ai propri clienti di una nuova piattaforma di sviluppo di un dispositivo FFSA™ (Fit Fast Structured Array) nel nodo di processo da 130nm. Questa piattaforma di sviluppo innovativa e ad alte prestazioni per System-on-Chip (SoC) fornisce soluzioni personalizzate che sono caratterizzate da un consumo di potenza ridotto e da una fascia di prezzo contenuta.

Toshiba fornisce piattaforme ASIC (Application Specific IC) e FFSA™ che soddisfano i requisiti aziendali, ambientali e tecnologici dei clienti, e che offrono inoltre soluzioni efficienti per lo sviluppo personalizzato dei SoC. Utilizzando un approccio innovativo, tutti i dispositivi FFSA™ sono dotati di un livello master comune basato su silicio che è usato in combinazione con gli strati superiori di metallizzazione, i quali sono riservati e consentono di personalizzare il dispositivo.

La piattaforma FFSA™ soddisfa i requisiti dei clienti in termini di alte prestazioni e di consumo energetico ridotto; tuttavia, limitando la personalizzazione alle maschere degli strati di metallizzazione, consente anche di ridurre drasticamente i costi di sviluppo. Di conseguenza, i campioni e i dispositivi prodotti in volumi possono essere consegnati in tempi significativamente più brevi rispetto a quanto avviene con gli ASIC convenzionali. I clienti che utilizzano la metodologia di progetto e la libreria ASIC FFSA™ si assicurano prestazioni superiori e consumi più bassi rispetto a quanto è possibile ottenere con i Field Programmable Gate Array (FPGA).

Il nuovo processo FFSA™ da 130nm si aggiunge all'attuale portafoglio di processi da 28, 40 e 65 nm di Toshiba, aggiungendo un'ulteriore opzione per gli apparecchi industriali. Il nodo di processo da 130nm offre diverse slice master con un massimo di 664kb di RAM e circa 912.000 gate per dispositivo.

I dispositivi progettati sulla piattaforma saranno fabbricati da Japan Semiconductor, una filiale di Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation con una lunga e comprovata esperienza e competenza nella produzione di ASIC, ASSP e microcomputer. Questo garantirà continuità della fornitura nel lungo termine e soddisferà o supererà i requisiti dei clienti in termini di continuità operativa.

I dispositivi basati sul nuovo nodo di processo FFSA™ da 130nm forniscono le prestazioni e l'integrazione necessarie per diversi settori applicativi, tra cui gli apparecchi industriali, le tecnologie di comunicazione, gli apparecchi per l'automazione d'ufficio e altro ancora.

Segui il link qui sotto per ulteriori informazioni sul nuovo prodotto:

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/custom-soc/platform/ffsa.html>

Note:

[1] Il numero di porte disponibili è orientativo e varierà in base all'applicazione

\* FFSA™ è un marchio di Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation.

\* Qualsiasi altro nome di società, denominazione di prodotto e designazione di servizio potrebbero essere marchi delle rispettive aziende.

###

## Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Tomoaki Kumagai.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

## Indirizzo di riferimento da pubblicare:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania

Tel: +49 (0) 211 5296 0      Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail: [discrete-ic@toshiba-components.com](mailto:discrete-ic@toshiba-components.com)

## Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

## Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)